附件1

集成电路产业财政奖补政策项目申报表

申请主体（盖章） 申请日期： 年 月 日

| **项目申请主体填写** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申请主体**  **基本情况** | 申请主体名称 |  | | | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | | |
| 联 系 人 |  | 电话 |  | | 手机 | |  |
| **项目基本情况（流片费用补贴项目填写）** | 项目名称 |  | | | | | | |
| 项目类型 | 多项目晶圆流片□ 全掩膜流片□ | | | | | | |
| 产品工艺 | 工艺制程 纳米□ 以碳化硅晶片作为衬底□ | | | | | | |
| 流片费用 |  | | | 申请补助金额 | |  | |
| **项目基本情况（封装测试公共服务平台项目填写）** | 项目名称 |  | | | | | | |
| 服务企业数量 |  | | | | | | |
| 服务收入（万元） |  | | | | | | |
| 申请补助（万元） |  | | | | | | |
| **审批部门填写** | | | | | | | | |
| **市级部门初审意见** | （盖章）：  年 月 日 | | | | | | | |
| **省级部门审核意见** | （盖章）：  年 月 日 | | | | | | | |